

氧化铝黑瓷膜

日期:2022.1.10

黑瓷生瓷带性能参数

名称	92 氧化铝黑瓷
生瓷带厚度(um)	195
层烧结厚度(um)	150
表面测粗度	≤10
烧结收缩率(X、Y)	15.7±0.3%
烧结收缩率(Z)	23.1±0.3%
介电常数	9.1 (13GHz)
介质损耗	0.001 (1MHz)
热导率(W/mk)	17
热膨胀系数(ppm/°C)	6.9
抗折强度(MPa)	≥400
绝缘电阻(Ω)	10 ¹¹
击穿电压 (V/mil)	≥1000
等静压条件	3000psi, 60-70°C预热 10min, 保压 10min
烧结条件	氮气+湿 H ₂ ; 1550-1600°C, 2h
储存条件	洁净密封、18-28°C, 相对湿度 40-70RH

注:生瓷膜厚度可从 50-250um 可定制。

苏州泓湃科技有限公司

苏州工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城中西北区 2 栋 203 室

TEL: 0512-81668260

www.hongpaikeji.com